


ECTC(2026/5/26-29@米国・オーランド)出展のご案内

三菱マテリアル株式会社は、100%子会社の米国三菱マテリアル社と共同で5月26日(火)から29日(金)に米国フロリダ州オーランドにて開催される半導体関連学会「ECTC(2026 IEEE 76th Electronic Components and Technology Conference)  (英語)」に併設される展示会に出展いたします。

ECTCは半導体関連を中心としたパッケージング、電子部品、マイクロエレクトロニクスシステム等幅広い分野の技術者が一堂に会し、最先端技術、業界・市場動向に関する情報発信が行われる世界最大級の国際学会です。

本学会に併設される展示会では、当社グループが掲げる「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する ～ Circulating resources for a sustainable future ～」をテーマに、半導体分野に向けた各種製品・技術を展示します。

世界的に高いシェアを有するバンブ形成用低 α 線 Pb フリーはんだめっき液および AuSn 合金ペーストをはじめ、商標出願中の角型 Si 基板「Kakugata™」、高熱伝導・低熱膨張率を特長とする金属基複合材料、さらにユニークなメカニズムで接合に寄与するナノポーラス Cu めっきなど、半導体関連製品をご紹介します。

本学会にお越しの際は、是非弊社ブースにお立ち寄りください。

プログラム

[About ECTC - ECTC](#)

出展期間

2026年5月26日(火) ～29日(金)

会場

JW Marriott & The Ritz-Carlton Grand Lakes Resort

4040 Central Florida Parkway, Orlando, Florida, USA 32837

当社ブース番号：409

お問い合わせ先

[Mitsubishi Materials U.S.A. Corporation](#)

[Electronic Materials and Components Division, Electronics Materials Department](#)

[E-mail: electronicmaterials@mmus.com](mailto:electronicmaterials@mmus.com)



